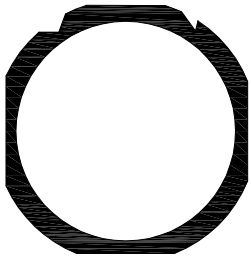


江苏芯丰集成电路封装压焊图

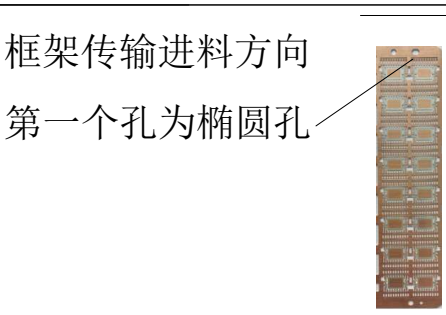
图号:314BD011

版本A.0

贴片方向（芯片与片环方向示意图）

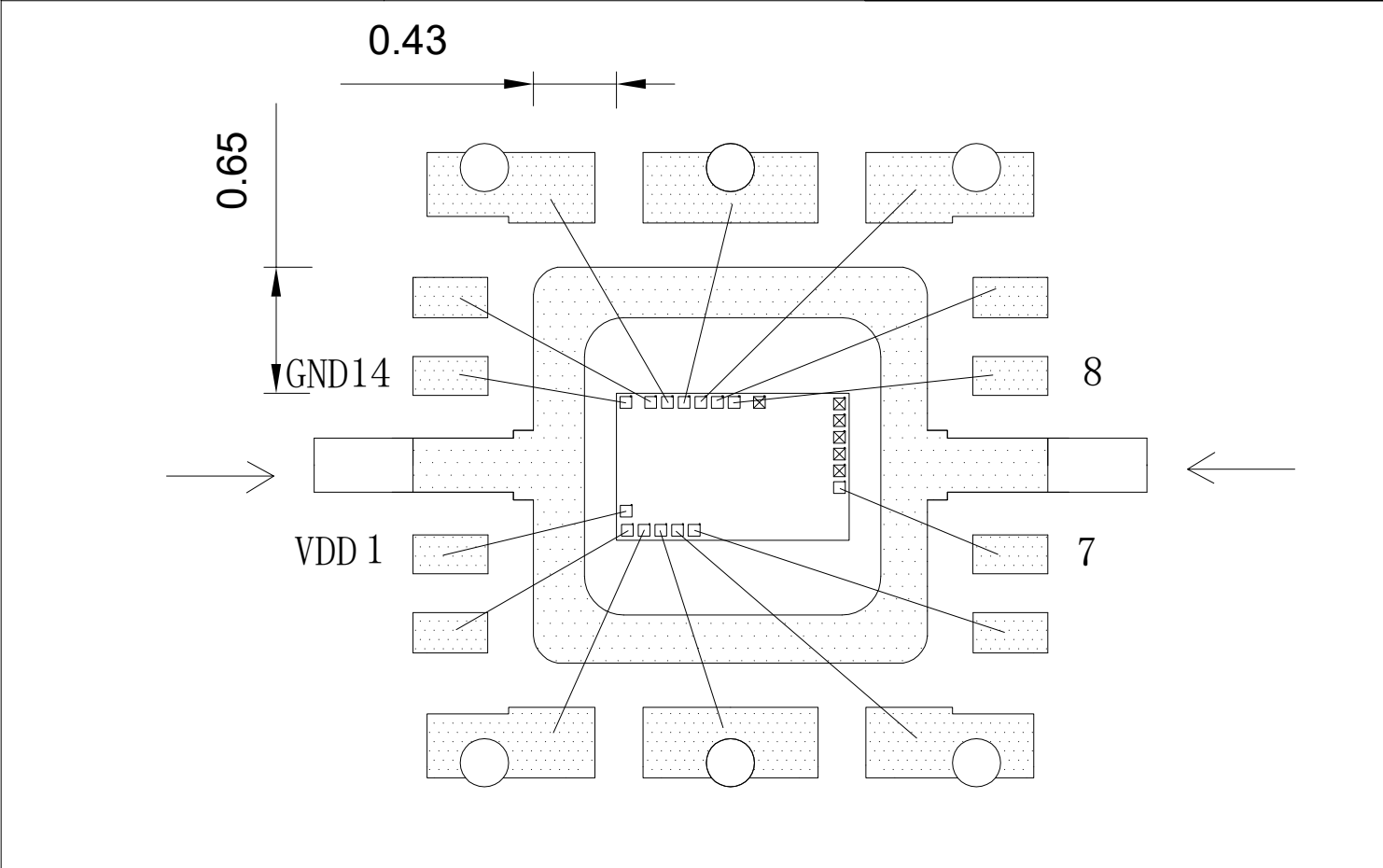


框架传输进料方向
第一个孔为椭圆孔



备注及特殊要求（Remark&Special Instruction）

框架到芯片最高点的线弧高度<550um
居中装片



请仔细核对焊线位置，以及材料选择。 如无误
请签字回传，谢谢！

客户回签：

顶针		点胶方式		如选择UV膜 请确认 产品是否可以照 射紫外线， 如不能请讲明	<input type="checkbox"/> UV膜 <input checked="" type="checkbox"/> 蓝膜	风险监控： 低风险					
单顶针	多顶针	点胶	画胶								
	/		/								
产品型号 (Product Type)		HS26P10		线 材 直 径 (Wire Diameter)		银合金线0.8mil		芯片减薄厚度 Chip thinning thickness		300±10um	
芯片名称 (Die Name)		HS5085		压焊点尺寸 (Pad Opening)		60X60um		装片胶 Epoxy (二选一)		首选	9246LB5(导电胶)
芯片尺寸 (Die Size)		1.195X0.755mm		最小压焊间距 (Min Pitch)		86um				备选	/
封装形式 (Package Type)		SOP14(8.65X3.9X1.4 e=1.27)		先 焊 线 (Wire Bond Start)		PIN14		塑封料 Molding Compound (二选一)		首选	EMC-GR710F GN
引 线 框 (Lead Frame)		SOP14L(80X80)-12R		焊 线 总 数 (Quantity of Wire)		14				备选	EMG-600-2-SP1
L/F电镀方式 (L/F Plating Type)		雾 锡		最长线长/总线长 (Length of Wire)		1.67/17.029mm		CUP/BOAC		<input checked="" type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO	
晶圆尺寸/切割方式 (Wafer Size/Cutting Mode)		8寸/刀片开槽+刀片切割		顶层铝厚度 (Top aluminum thickness)		1.5um		RF 芯片		<input type="checkbox"/> YES <input checked="" type="checkbox"/> NO	
吸 嘴 (suction nozzle)		RT-020-020-FT		切割道(Cutting Way)		60um		LOW-K芯片		<input type="checkbox"/> YES <input checked="" type="checkbox"/> NO	
拟制 Prepared by		顾馨 2024.04.18		审核 Checked by				批准 Approved by			